

证券代码：688182

证券简称：灿勤科技

江苏灿勤科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2023年12月27日)

编号：2023-021

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（线上会议、券商策略会）
参与单位名称及人员姓名	国信证券
时间	2023年12月27日
地点	灿勤科技会议室
上市公司接待人员姓名	董事、董事会秘书：陈晨女士 证券事务代表：钱志红女士
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：告知保密义务 第二部分：问答环节 1、问：公司的主营业务是什么，有哪些应用领域？ 答：公司主要从事高端先进电子陶瓷元器件的研发、生产和销售。产品主要包括滤波器、谐振器、天线等元器件，并以低互调无源组件、金属陶瓷结构与功能器件、射频模块与系统等多种产品作为补充。产品广泛应用于移动通信、雷达、射频电路、数据链、电子侦查与干扰、卫星通讯导航与定位、航空航天与国防科工、新能源、半导体、万物互联等领域。公司自成立以来，依托在陶瓷粉体配方和产品制备工艺领域的持续研发和经验积累，始终专注于电子陶瓷元器件的研制和开发。公司通过向客户提供高效稳定、专业可靠的元器件产品及通信解决方案，不断提升企业的品牌与价值,谢谢。 2、问：公司2023年第三季度的经营业绩情况？ 答：2023年1-9月，公司实现营业收入26,268.44万元，较上年同期增加5.32%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润为 1,167.29 万元，较上年同期减少 10.15%，主要原因是收到的政府补助与上年同期相比大幅下降所致，同时公司增加研发投入，以及管理费用增加所致。2023 年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 259.43 万元，较上年同期下降 62.02%，主要系第三季度销售规模同比有所下降，同时公司增加研发投入，以及管理费用增加所致。截至 2023 年 9 月 30 日，公司财务状况良好，总资产 22.86 亿元，较上年度末下降 1.35%，归属于上市公司股东的净资产 21.17 亿元，较上年度末增加 0.52%，谢谢。

3、问：公司 HTCC 陶瓷产品，主要包括哪些产品，用于哪些领域？

答：陶瓷基板、陶瓷基座、管壳，主要这三大类，主要应用于新能源、IGBT 热管理、半导体封装和无线通信等领域，谢谢。

4、问：公司电子陶瓷产品在 HTCC 领域的发展情况？

答：随着万物互联时代的到来，电子系统整机对电路尺寸、密度、功能性、可靠性及功率均提出了更高的要求；因 HTCC（高温共烧多层陶瓷）元器件及组件在尺寸、成本、功能、可靠性等方面能够满足电子系统整机对电路的诸多要求，在近几年获得了广泛的关注。公司募集资金投资项目拟生产的 HTCC 电子陶瓷产品将主要应用于高可靠半导体、国防科工的各类应用场景以及高频通讯移动终端，包括汽车电子、计算机、远程医疗、智能家居、高频通讯等。

5G 通信对终端电子元器件提出了小型化、轻量化、低成本、高性能的技术发展要求，发展高性能 HTCC 电子陶瓷产品将成为 5G 及万物互联时代的迫切需要。基于 HTCC 技术的电子陶瓷元器件、陶瓷封装、陶瓷基板等产品可实现 5G 及万物互联所需的高性能，同时还具有大规模量产潜能、较高的环境耐受性等，使灵活的 5G 及万物互联通信终端设计成为可能。

在 HTCC 领域，国内厂商起步较晚，在技术积累方面也较为缓慢，导致 HTCC 产业与国外企业的差距越来越大。随着高端市场对 HTCC 元器件、陶瓷封装、大功率陶瓷基板等需求的增长，国内厂商也开始意识到 HTCC 技术的重要性和巨大的发展空间。此外，受国际贸易摩擦影响，HTCC 产品国产化替代的市场空间巨大。由于 HTCC 行业技术门槛较高，目前仅有少数国内厂商在着手研发 HTCC 技术，形成批量供应能力的企业更是少数，技术能力和产量水平目前还远远不能满足国内相关领域的发展需求。

未来，随着 5G 应用、万物互联等市场的发展，对 HTCC 电子陶瓷产品的需求量会进一步增加。国内企业需要进一步提升自身的工艺水平和技术能力，提高自身产品的竞争力。对目标产品核心技术的突破将帮助实现我国 HTCC 电子陶瓷产品的进口替代，促进通信产业上下游的快速健康发展，提升我国在相关领域

	<p>的国际竞争力。</p> <p>公司自成立以来，一直深耕于电子陶瓷材料及射频器件产品技术的研发与生产，在电子陶瓷材料的制备工艺方面具有长期的技术积累，储备了 HTCC 产品所需的材料配方、印刷、金属化、共烧、测试等相关工艺技术，因此具有技术可实现性，部分生产设备也具有通用性。同时，公司积累了大量优质的客户资源，公司目前的诸多客户均在使用 HTCC 电子陶瓷产品，因此公司生产的 HTCC 电子陶瓷产品容易获取相应的市场资源和客户资源，同时将有进一步开拓新能源、半导体等领域的新客户。</p> <p>公司目前已具备生产 HTCC 电子陶瓷产品所需的部分核心技术和客户资源，进入 HTCC 市场的风险较低。公司将结合市场需求不断改进制造工艺和技术，进一步加大在 HTCC 技术领域的研发投入，力争实现工艺的快速成熟、产品的核心指标水平达到并超越国内外竞争对手。截至目前，公司 HTCC 相关产品线逐步丰富，多款陶瓷基板、管壳等产品在半导体、新能源、无线通信等领域的客户开始送样，并取得阶段性进展，谢谢。</p>
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 12 月 29 日